

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年8月7日
【会社名】	シャープ株式会社
【英訳名】	Sharp Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 河村 哲治
【本店の所在の場所】	大阪府中央区久太郎町二丁目1番25号
【電話番号】	06-6271-1912（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部 財務部 財務グループ 部長 中尾 佳永
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区久太郎町二丁目1番25号
【電話番号】	06-6271-1912（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部 財務部 財務グループ 部長 中尾 佳永
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

当社は2026年8月7日開催の取締役会において、以下の組織再編（以下「本組織再編」といいます。）を決議し、同日付で吸収合併契約及び吸収分割契約を締結しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第7号及び第7号の3の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

- ① 2026年10月1日を効力発生日として、シャープディスプレイテクノロジー株式会社（以下、「SDTC社」といいます。）を存続会社、SDTC社の完全子会社（当社孫会社）であるシャープフロンティアオートモーティブテクノロジー株式会社を消滅会社とする吸収合併を行います（以下、「第1合併」といいます。）。
- ② 第1合併の効力発生を条件として、2026年10月1日を効力発生日として、当社を存続会社、当社の完全子会社であるSDTC社を消滅会社とする吸収合併を行います（以下、「第2合併」といいます。）。
- ③ 第2合併の効力発生を条件として、2026年10月1日を効力発生日として、当社を存続会社、SDTC社の完全子会社（第2合併後、当社完全子会社）であるシャープ米子株式会社（以下、「SYC社」といいます。）を消滅会社とする吸収合併を行います。
- ④ 第2合併の効力発生を条件として、2026年10月1日を効力発生日として、SDTC社の完全子会社（第2合併後、当社完全子会社）であるシャープディスプレイマニファクチャリング株式会社（以下、「SDMC社」といいます。）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割により、SDMC社から白山工場における液晶パネル生産事業を当社に承継します。
- ⑤ 2027年4月1日を効力発生日として、当社を存続会社、SDTC社の完全子会社（第2合併後、当社完全子会社）であるシャープディスプレイカラーフィルター株式会社（以下、「SDCC社」といいます。）を消滅会社とする吸収合併を行います。

2【報告内容】

1. 特定子会社の異動に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告）

（1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

- ① 名称 : シャープディスプレイテクノロジー株式会社
- ② 住所 : 三重県亀山市白木町幸川464番
- ③ 代表者の氏名 : 代表取締役社長・川合 勝博
- ④ 資本金 : 100,000,000円
- ⑤ 事業の内容 : ディスプレイデバイス及びディスプレイ技術応用商品の企画・開発・設計・製造・販売

（2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

- ① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 : 2,000個
異動後 : ー
- ② 総株主等の議決権に対する割合
異動前 : 100%
異動後 : ー

（3）当該異動の理由及びその年月日

- ① 異動の理由 : 当社が、当社の特定子会社であるSDTC社を吸収合併することにより、同社は消滅するものです。
- ② 異動の年月日 : 2026年10月1日（本組織再編における第2合併の効力発生日）

2. 吸収合併に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3に基づく報告）

（1）当該吸収合併の相手会社についての事項

①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

a.SDTC社

商号	シャープディスプレイテクノロジー株式会社
本店の所在地	三重県亀山市白木町幸川464番
代表者の氏名	代表取締役社長・川合 勝博
資本金の額	100,000,000円
純資産の額	△196,747百万円（2026年3月31日現在）
総資産の額	41,730百万円（2026年3月31日現在）
事業の内容	ディスプレイデバイス及びディスプレイ技術応用商品の企画・開発・設計・製造・販売

b.SYC社

商号	シャープ米子株式会社
本店の所在地	鳥取県米子市石州府字大塚ノ貳650番
代表者の氏名	代表取締役社長・谷口 洋二
資本金の額	100,000,000円
純資産の額	△3,199百万円（2026年3月31日現在）
総資産の額	236百万円（2026年3月31日現在）
事業の内容	その他機械器具の開発・製造及び販売、商品のサービスに関する事業及び業務等

c.SDCC社

商号	シャープディスプレイカラーフィルター株式会社
本店の所在地	三重県津市森町5009番2 ニューファクトリーひさい工業団地
代表者の氏名	代表取締役社長・島戸 幸和
資本金の額	50,000,000円
純資産の額	△1,098百万円（2026年3月31日現在）
総資産の額	1,851百万円（2026年3月31日現在）
事業の内容	液晶ディスプレイ用カラーフィルターの製造・販売

②直近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益（単位：百万円）

a.SDTC社

事業年度	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
売上高	391,416	341,171	267,974
営業利益又は営業損失（△）	△ 88,561	△ 46,581	△ 31,173
経常利益又は経常損失（△）	△ 89,655	△ 42,964	△ 33,229
当期純利益又は当期純損失（△）	△ 116,868	△ 36,952	△ 48,111

b.SYC社

事業年度	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
売上高	1,040	810	451
営業利益又は営業損失（△）	56	13	△ 80
経常利益又は経常損失（△）	60	18	△ 89
当期純利益又は当期純損失（△）	78	△ 53	△ 2,319

c.SDCC社

事業年度	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
売上高	4,562	4,653	4,583
営業利益又は営業損失（△）	125	107	118
経常利益又は経常損失（△）	130	115	126
当期純利益又は当期純損失（△）	84	101	△ 1,160

③大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

a.SDTC社

大株主の名称	シャープ株式会社
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	100%

b.SYC社

大株主の名称	シャープディスプレイテクノロジー株式会社
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	100%

c.SDCC社

大株主の名称	シャープディスプレイテクノロジー株式会社
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	100%

④当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

a.SDTC社

資本関係	同社は当社の完全子会社であります。
人的関係	当社から同社には取締役を派遣しています。
取引関係	当社と同社との間には、ディスプレイ関連製品の取引及び資金の貸付取引があります。

b.SYC社

資本関係	同社は当社の連結子会社であり、SDTC社の完全子会社であります。
------	----------------------------------

人的関係	当社から同社には取締役を派遣しています。
取引関係	当社と同社との間には、主に資金の貸付取引があります。

c.SDCC社

資本関係	同社は当社の連結子会社であり、SDTC社の完全子会社であります。
人的関係	当社から同社には取締役を派遣しています。
取引関係	当社と同社との間には、ディスプレイ関連製品の取引があります。

(2) 当該吸収合併の目的

当社グループのディスプレイデバイス事業は、事業環境の変化に対応するため、生産能力の最適化や固定費削減をはじめとする構造改革を進めてまいりましたが、本年12月予定の亀山第2工場の生産停止などにより、2026年度で一連の構造改革に区切りがつく見通しです。

注力事業である車載向け及びモバイル・産業向けの高付加価値製品を中心とする事業へのシフトが着実に進展する中、さらなる収益力強化に向けた事業運営の効率化及びガバナンス強化を図るため、グループ内に分散するディスプレイデバイス関連の組織及び機能を当社に再統合することといたしました。

本組織再編により、事業運営機能の集約及び管理コストの削減を進めるとともに、当社グループ全体での経営資源の最適活用を図ることで、再成長を加速してまいります。また、ディスプレイデバイス事業においては、高付加価値製品を中心とする事業の成長を図るとともに、これまで培ってきたディスプレイ関連技術を活用し、光学部材や各種センサーデバイスなどの新規事業の創出を加速することで、新たな収益源の獲得を目指してまいります。

(3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

①吸収合併の方法

1 提出理由 に記載したとおりです。

②吸収合併に係る割当ての内容

いずれも完全子会社との合併のため、各合併に際する新株式の発行及び金銭等の交付はありません。

③その他の吸収合併契約の内容

各合併の日程

a.SDTC社

取締役会決議日	2026年8月7日
合併契約締結日	2026年8月7日（予定）
実施予定日（効力発生日）	2026年10月1日（予定）

b.SYC社

取締役会決議日	2026年8月7日
合併契約締結日	2026年8月7日（予定）
実施予定日（効力発生日）	2026年10月1日（予定）

c.SDCC社

取締役会決議日	2026年8月7日
合併契約締結日	2026年8月7日（予定）
実施予定日（効力発生日）	2027年4月1日（予定）

※これらの合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易吸収合併、SDTC社、SYC社及びSDCC社においては会社法第784条第1項に規定する略式吸収合併であるため、いずれも合併契約承認に関する株主総会決議を経ずに行います。

(4) 当該吸収合併に係る割当ての内容の算出根拠

該当事項はありません。

(5) 当該吸収合併の後の合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	シャープ株式会社
本店の所在地	大阪市中央区久太郎町二丁目1番25号
代表者の氏名	代表取締役社長・河村 哲治
資本金の額	5,005,077,890円（2026年3月31日現在）
純資産の額	295,284百万円（2026年3月31日現在）
総資産の額	1,428,253百万円（2026年3月31日現在）

事業の内容	電子通信機器・電気機器及び電子応用機器全般・電子部品の製造・販売等
-------	-----------------------------------

3. 吸収分割に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号に基づく報告）

（1）当該吸収分割の相手会社についての事項

①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	シャープディスプレイマニュファクチャリング株式会社
本店の所在地	三重県津市安濃町戸島2010番地
代表者の氏名	代表取締役社長・橋本 隆治
資本金の額	95,000,000円
純資産の額	1,422百万円（2026年3月31日現在）
総資産の額	11,136百万円（2026年3月31日現在）
事業の内容	ディスプレイデバイス事業の製造・販売及びサービス事業

②直近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益（単位：百万円）

事業年度	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
売上高	12,815	14,173	20,655
営業利益又は営業損失（△）	488	341	230
経常利益又は経常損失（△）	487	345	249
当期純利益又は当期純損失（△）	319	225	74

③大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称	シャープディスプレイテクノロジー株式会社
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	100%

④当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	同社は当社子会社であるSDTC社の完全子会社であります。
人的関係	当社から同社には取締役を派遣しています。
取引関係	当社と同社との間には、ディスプレイ関連製品の取引があります。

（2）当該吸収分割の目的

2. （2）当該吸収合併の目的と同一です。

（3）当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

①吸収分割の方法

1 提出理由 に記載したとおりです。

②吸収分割に係る割当ての内容

完全子会社との吸収分割のため、吸収分割に際する新株式の発行及び金銭等の交付はありません。

③その他の吸収分割契約の内容

本吸収分割の日程

取締役会決議日	2026年8月7日
分割契約締結日	2026年8月7日（予定）
実施予定日（効力発生日）	2026年10月1日（予定）

※本吸収分割は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易吸収分割、SDMC社においては会社法第784条第1項に規定する略式吸収分割に該当するため、いずれも分割契約承認に関する株主総会決議を経ずに行います。

（4）当該吸収分割に係る割当ての内容の算出根拠

該当事項はありません。

（5）当該吸収分割後の承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	シャープ株式会社
本店の所在地	大阪市中央区久太郎町二丁目1番25号

代表者の氏名	代表取締役社長・河村 哲治
資本金の額	5,005,077,890円（2026年3月31日現在）
純資産の額	295,284百万円（2026年3月31日現在）
総資産の額	1,428,253百万円（2026年3月31日現在）
事業の内容	電子通信機器・電気機器及び電子応用機器全般・電子部品の製造・販売等

以 上